

平成19年度 研究開発助成金 交付決定先一覧

企業名	代表者	住 所	資本金 (百万円)	従業員 (人)	設 立	プロジェクト名
(株) アーティセル・システムズ http://www.articell.co.jp/	中山 洋一	神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 かながわサイエンスパーク4階 TEL044-812-0188	32.075	6	H18.5	遺伝子制御ネットワークの動的シミュレーション装置の開発
(株) アーバンマテリアルズ http://www.urbanmat.co.jp/	大神田 佳平	兵庫県芦屋市楠町15-7 M3ビル TEL0797-34-6101	97	7	H15.10	Fe-Al系系制振合金「アルフェ」の開発
(株) ヴィッツ http://www.witz-inc.co.jp	脇田 周爾	愛知県名古屋市中区栄2-13-1 白川第2ビル TEL052-220-1218	20	75	H9.6	自動車統合制御用組込みOSの実用化開発
(株) オーエムワイ http://www.omv.co.jp	森川 剛吉	大阪府大阪市中央区安堂寺町2-1-15 TEL06-6764-7502	10	3	H16.6	スライドカッター(安全テープカッター)の開発及び販路開拓
(株) 大阪電子科学技術研究所 http://www.osaka-denshi.co.jp	大藪 敏雄	滋賀県大津市南比良525-5 TEL077-566-3248	30	4	H17.1	液晶精密測長器を用いたリニアステージ (リニアモータ・システム)の研究開発
(株) 計測リサーチコンサルタント http://www.krcnet.co.jp/	岡本 卓慈	広島県広島市東区福田1-665-1 TEL082-899-5471	39	89	S47.11	既存ケーブル部材の現有応力測定を可能にする UタイプEMセンサの開発
(有) コンタミネーション・コントロール・サービス	進藤 豊彦	神奈川県相模原市下九沢529-3 TEL042-764-3725	3	1	H12.1	金属製パーツ内面へのDLC (ダイヤモンド・ライク・カーボン)成膜技術の開発
サイエナジー (株) http://www.scienergy.jp	元田 良一	神奈川県相模原市西橋本5-4-30 SIC-2 305号 TEL042-770-9971	40	5	H17.4	ガス電子増幅方式粒子線線量モニターの開発
(株) 大和テクノシステムズ http://www.daiwatechno.co.jp	佐藤 洋	東京都町田市玉川学園4-24-24 TEL042-723-1211	12	32	S42.4	オスミウムコーティング技術の開発
日本パルスモーター (株) http://www.pulsemotor.com	橋立 弘紀	東京都文京区本郷4-1-4 コスモ本郷ビル7階 TEL03-3813-8841	140	315	S27.5	DFR(二重境膜剥ぎ取り)熱交換器導入による 小型吸収式冷凍機の開発
(株) リドクシオン http://www.redoxyon.com	三野 哲也	東京都千代田区東神田2-9-2 TEL03-5939-6401	42.5	10	H18.12	極低酸素分圧発生装置向けの酸素ポンプの開発

助成金応募総数 180件

助成金交付決定先件数・金額 11件 33,000千円